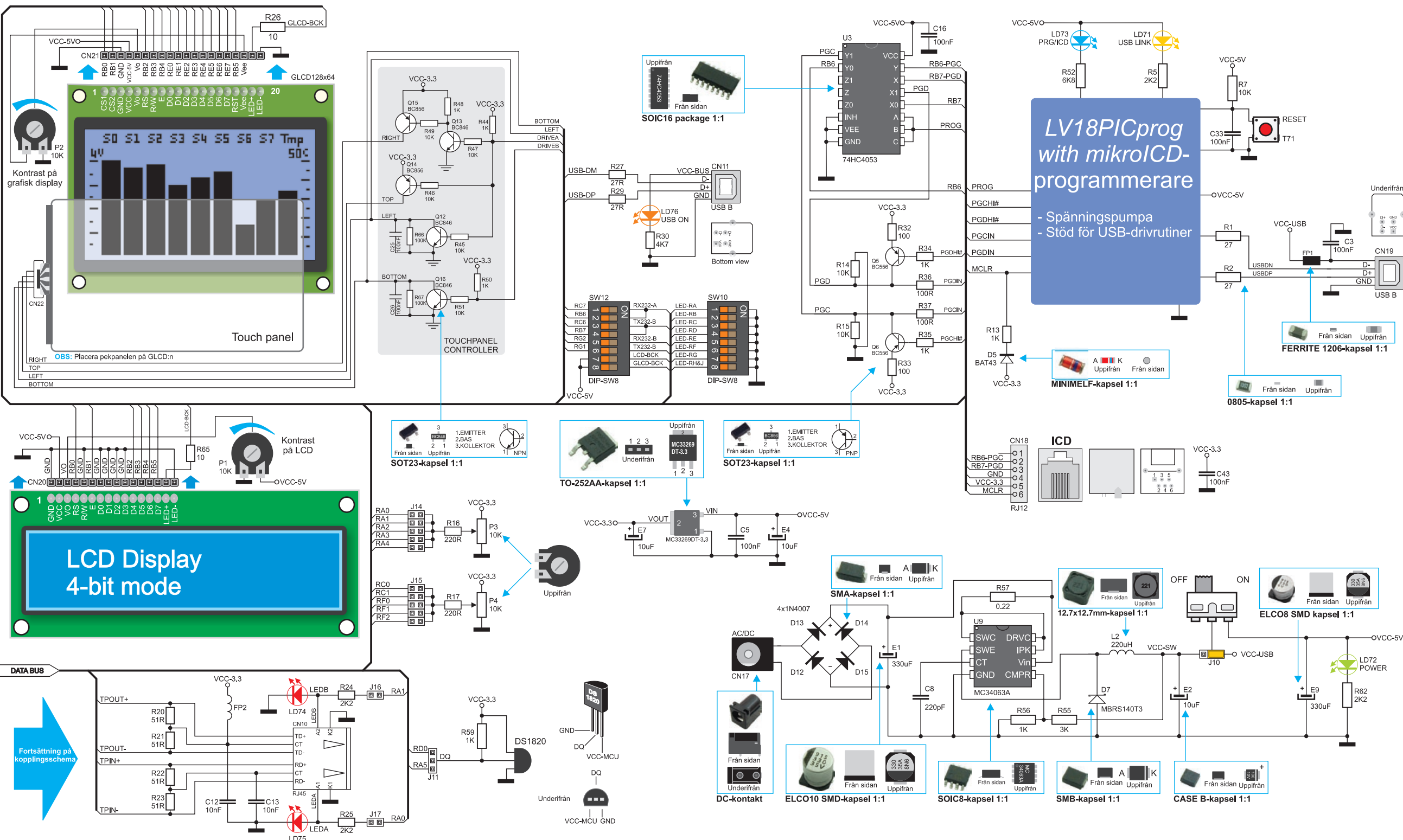


Utvecklingssystem

LV18F v6™

Detta dokument innehåller ett komplett kopplingsschema över utvecklingssystemet EasyPIC6. Systemet är designat med omsorg och särskild uppmärksamhet har ägnats åt valet av ingående komponenter. Detta är anledning till att de viktigaste delarna av systemet tillverkas i SMD (Surface Mounting Device) teknologi. Komponenterna monteras dessutom av maskiner av den senaste generationen vilka använder en blyfri legering för lödning. Vad vi nu har som ett resultat är en högkvalitativ och pålitlig produkt som uppfyller världens högsta standarder som tillämpas inom elektronikindustri och miljöskydd.

MikroElektronika
SOFTWARE AND HARDWARE SOLUTIONS FOR EMBEDDED WORLD ...making it simple



Översikt av kapslingar för ytmonterade komponenter

 1:1 Från sidan Uppifrån 0805	 1:1 Från sidan Uppifrån 0805	 1:1 Från sidan Uppifrån ELCO10 SMD	 1:1 Från sidan Uppifrån ELCO10 SMD	 1:1 Från sidan Uppifrån CASE B
 1:1 Från sidan Uppifrån Ferrite 1206	 1:1 Från sidan Uppifrån 12.7x12.7mm	 1:1 Från sidan Uppifrån IND 1812	 1:1 Från sidan Inuti Uppifrån 6x6-TRYCKKNAPP	 1:1 Från sidan Inuti Uppifrån 4.5x4.5-TRYCKKNAPP
 1:1 Från sidan Underifrån SMD Kvarstkristall	 1:1 Från sidan A Uppifrån K SMA	 1:1 A K Från sidan A K Uppifrån PLCC-2 ytmonterad lysdiod	 1:1 Från sidan A Uppifrån K SMB	 1:1 Från sidan BAT43 A K Uppifrån MINIMELF
 1:1 1.EMITTER 2.BAS 3.KOLLEKTOR Uppifrån Från sidan SOT23	 1:1 1.EMITTER 2.BAS 3.KOLLEKTOR Uppifrån Från sidan SOT23	 1:1 Från sidan Uppifrån SOIC8	 1:1 Från sidan Uppifrån SOIC16	 1:1 Från sidan Uppifrån SOIC28
 1:1 Från sidan Uppifrån Potentiometer	 1:1 Från sidan Uppifrån Underifrån TO-252AA	Byglingar 1 2 3 Alla ben är lediga 1 2 Ben 1 och 2 är anslutna		DIP-strömställare 1 2 3 4 5 6 7 8 Strömställare 1, 2, 3 och 4 är i ON-position 1 2 3 Strömställare 5, 6, 7 och 8 är i OFF-position

